

第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会

第二轮会议通知

随着摩尔定律逼近极限，通过特征尺寸微缩来实现性能翻倍难以持续。针对未来对电子系统小型化、高性能、智能化、低功耗的需求，集成微系统技术提供了一条从单片集成平面结构到多芯片集成立体结构的重要技术途径。集成微系统技术内涵为“微纳电子学+微纳光子学+MEMS/NEMS+架构+算法”五大技术与“传感+处理+通信+执行+能源”五大功能的深度融合，是“下一代技术革命”和“后摩尔定律时代”的主要技术解决途径。与追求线宽减小的摩尔定律不同，集成微系统技术通过定制完成“从原子到产品、从材料到系统”的多样性与多功能集成，实现从“晶体管→集成电路→微模组（微系统）→集成微系统”的新一代技术革命，在小型化、集成化、智能化、频谱开发等领域具有重大应用价值。

集成微系统是多学科交叉的前沿科学技术，建模与仿真、微纳工艺、精密测试三大方面相辅相成，其中建模与仿真是其研究基础，需要从微纳层次的原子尺度出发，结合设计与微纳工艺，模拟仿真电子学、光子学、MEMS/NEMS，实现按需求从微观定制系统，获得先进新颖的系统功能，衍生出射频毫米波太赫兹波微系统、MEMS/NEMS 微系统、智能传感微系统、异构计算与信号处理微系统、量子与光电微系统、高电压微系统、生物微系统等颠覆性的新功能微系统。同时研究环境因素影响集成微系统性能的“原子-材料-器件-系统”的跨尺度建模和仿真方法，提升系统综合性能。

中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会是 2017 年经中国科协和中国仿真学会批准成立的分支机构。第四届全国集成微系统建模与仿真学术交流会，由电子科技大学长三角研究院（湖州）、中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会主办，电子科技大学，电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院，杭州电子科技大学射频电路与系统教育部重点实验室，江苏省多维感知信息技术联合实验室，宽带微波电路高密度集成四川省工程研究中心，雷达探测感知全国

重点实验室，微组装技术创新中心，浙江大学信息与电子工程学院，浙江省半导体行业协会等协办，拟于2025年8月22-24日在浙江省湖州市南浔福朋喜来登酒店举行，会议期间将举办中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会2025年度工作会议。

一、大会组委会

大会主席：崔铁军、毛军发、胡俊、赵元富

大会副主席：林先其、孙玲玲、李文钧、陈红胜

大会执行主席：徐跃杭、刘军、王作佳

大会程序委员主席：张健

大会程序委员副主席：李沫、周浩、黄乐天、赵文生、陈文超

程序委员会（按姓氏首字母排序）：鲍飞鸿、曹俊诚、曹文翰、陈飞良、陈全、池保勇、代刚、邓小川、董森华、范谱、高建军、郭红霞、郭旗、关雪飞、郝继山、郝加明、何昀、贺朝会、黄婉霞、康凯、李泠、李轩、梁木生、梁兴东、林秦豪、刘志强、卢本卓、罗雪梅、毛书漫、孟晓东、单光宝、邵汉儒、谭晓衡、汤晓燕、唐旻、王燕、王维波、王祁钰、王曾晖、汪志强、谢小平、徐宁、邢朝洋、薛建明、杨帆、杨雪松、余浩、曾耿华、曾勃、张傲、张颖朦、张伟、赵毅、赵永红、郑朝月、周再发、周斌、周海京、周洪澄、周雷、左旭

组织委员会主席：韩田田

组织委员会副主席：李草禹、蔡佳林、胥鑫、李阳明

组织委员会（按姓氏首字母排序）：陈昶旗、罗宇轩、周治迪

二、大会报告嘉宾（按姓氏首字母排序）

曹俊诚，中国科学院上海微系统与信息技术研究所

陈红胜，浙江大学

丁大志，南京理工大学

郭宇锋，南京邮电大学

胡俊，电子科技大学

黄志祥，安徽大学

鲁中海，香港科技大学（广州）

汪志强，中国电子科技集团有限公司

吴语茂，复旦大学

于宗光，中国电科 58 所

张健，电子科技大学

曾晓洋，复旦大学

赵元富，中国航天科技集团第九研究院

更多大会报告嘉宾详细信息请访问：<https://ncimms.cn/speaker.html>

三、会议时间、地点

1、时间：2025 年 8 月 22 -24 日，22 日报到。

2、地址：浙江省湖州市南浔福朋喜来登酒店

四、征文要求

1、征文范围

本次会议面向全国公开征文，征文范围包括但不限于以下主题：

- 1) 集成微系统的原子与材料级建模与仿真
- 2) 集成微系统的器件级建模与仿真
- 3) 集成微系统的电路与系统级建模与仿真
- 4) 集成微系统跨空间、跨时间尺度建模与仿真
- 5) 微纳电子学建模与仿真
- 6) 微纳光子学建模与仿真
- 7) MEMS/NEMS 与微纳力学建模与仿真
- 8) 微系统三维异质异构集成建模与仿真
- 9) 微纳工艺过程建模与仿真

- 10) 集成微系统电、磁、光、热、力多物理场建模与仿真技术
- 11) 微系统与环境（辐射、气氛、应力等）相互作用物理过程与效应机理建模与仿真
- 12) 典型新功能微系统的建模与仿真（毫米波太赫兹波微系统、智能传感微系统、异构计算与信号处理微系统、量子与光电微系统、高电压微系统、抗辐照微系统、生物微系统等）
- 13) 集成微系统仿真中的高性能算法
- 14) 集成微系统仿真可视化技术与平台技术
- 15) 集成微系统半实物模拟仿真技术
- 16) 集成微系统仿真性能评估技术
- 17) 集成微系统 EDA 技术
- 18) AI（人工智能）微系统技术

2、论坛召集人

- 主题方向 A：异质异构集成/先进材料/多物理场建模仿真
召集人：陈文超，浙江大学；蒲 菠，宁波德图科技
- 主题方向 B：射频/光电/太赫兹微系统建模仿真
召集人：赵文生，杭州电子科技大学；李 沫，电子科技大学
- 主题方向 C：MEMS/NEMS 微系统建模仿真
召集人：王曾晖，电子科技大学；杨 睿，上海交通大学
- 主题方向 D：Chiplet/SOC/IC 建模仿真与 EDA
召集人：黄乐天，电子科技大学；王小航，浙江大学
- 主题方向 E：神经形态芯片与微系统
召集人：蔡道林，华东师范大学；马 德，浙江大学
- 主题方向 F：功率器件建模仿真与 EDA
召集人：汤晓燕，西安电子科技大学；邓小川，电子科技大学

3、报告形式

本次会议包括大会特邀报告、分会场报告、成果展览展示等。

大会将邀请相关的院士、著名专家进行特邀报告、分会场特邀报告。

会议按分会场报告的方式进行口头报告，包括邀请报告、部分优秀论文报告。

会议专门设定时间进行张贴报告。

4、论文征集

作者提供论文全文或详细摘要投稿，格式见[附件](#)。

5、论文审稿

投稿论文由会议程序委员会进行审稿，审稿原则是“宁缺勿滥，质量为先，重在创新，重在交流，鼓励年轻人投稿”。

5、摘要发布及论文推荐

大会将编辑发布论文摘要集供与会人员学习交流。

参加优秀论文评选的投稿应为不少于 4 页的全文，评选的优秀论文将推荐到 SCI 刊源期刊《Chinese Journal of Electronics》的特刊，按照[英文模板](#)修改后进行评审，大会鼓励参与评选优秀论文按《Chinese Journal of Electronics》模板直接投稿。其他中文优秀论文全文经作者许可将择优推荐到《系统仿真学报》、《太赫兹科学与电子信息学报》、《微电子与固体电子学报》等期刊发表。

五、征文重要时间表

- 1、论文投稿截止日期：2025 年 7 月 15 日
- 2、录用通知截止日期：2025 年 7 月 25 日
- 3、早鸟注册截止日期：2025 年 7 月 20 日
- 4、会议召开日期：2025 年 8 月 22 - 24 日（8 月 22 日签到）

六、投稿须知

会议采用线上投稿，投稿系统链接：<https://iconf.young.ac.cn/t83Jh>

七、会议注册

早鸟注册费（2025 年 7 月 20 日 24:00 前）：

1800 元 / 人，学生：1500 元 / 人

普通注册费（2025 年 7 月 21 日 00:00 起）：

2100 元 / 人，学生：1800 元 / 人

注册系统链接：<https://iconf.young.ac.cn/YXbVu>

八、会议联系信息

相关问题咨询请联系

大会秘书

钟 英

电话：18628263876

邮箱：imms@youngac.cn

更多会议信息请访问会议官网：<https://www.ncimms.cn/>

主办单位：

电子科技大学长三角研究院（湖州）

中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会

协办单位（按首字母排序）：

电子科技大学

电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院

杭州电子科技大学射频电路与系统教育部重点实验室

江苏省多维感知信息技术联合实验室

宽带微波电路高密度集成四川省工程研究中心

雷达探测感知全国重点实验室

微组装技术创新中心

浙江大学信息与电子工程学院

浙江省半导体行业协会

2025 年 6 月 25 日

附件：**投稿论文格式要求**

- 1、本次会议将印刷论文摘要作为会议资料，统一为 word 文档（A4 纸）。
- 2、要求论文观点明确、论证充分、文字简练，具有先进性、科学性、实用性。
- 3、详细摘要内容主要包括：论文题目、作者姓名、工作单位、通讯地址、邮政编码、电话、关键词、摘要、正文、参考文献。其中正文建议包括前言、方法、结果分析和结论。
- 4、正文字数不少于 1000 字，总页数应不少于 2 页。
- 5、论文格式如下。

论文题目（黑体小二，居中，1.5 倍行距）

作者（宋体，小四，居中，1.5 倍行距；多个作者之间使用逗号“，”间隔）

单位（楷体，小四，居中，1.5 倍行距；XXXXXX，请写单位全称）

摘要（黑体，小四，1.25 倍行距）：摘要正文（楷体，五号，200 字内）

关键词（黑体，小四，1.25 倍行距）：关键词（楷体，五号，3-6 个，使用分号“；”间隔）

1 一级标题（黑体，四号，1.5 倍行距，数字与题目间隔二字符）

1.1 二级标题（黑体，小四，1.5 倍行距，数字与题目间隔二字符）

1.1.1 三级标题（宋体，小四，1.5 倍行距，数字与题目间隔二字符）

正文（宋体，小四，首行缩进 2 字符，1.25 倍行距；英文，Times New Roman）。

图、表均使用黑体，五号，居中，各自从“1”开始编号。

图/表 1 XXXX（黑体，五号，数字与题目间隔一字符）

参考文献（黑体，小四）

[1] 作者名.篇名[J].书(期刊)名,年,卷(期):起止页码.(宋体,五号,英文,Times New Roman)